

香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

## SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司\*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：0981)

中芯截至二零零四年十二月三十一日止三个月销售额发布

本公司谨于今日公布截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核销售额。

- 销售额由上季的 274,900,000 元增至二零零四年第四季的 291,800,000 元，增幅 6.2%。较 2004 年第三季，晶圆付运增加 15.2% 至 303,796 片 8 吋等值晶圆。每月产能增加至 120,417 件 8 吋等值晶圆。中芯与台积电有关法律诉讼案件达成和解。
- 以下为本公司于二零零五年一月三十一日就截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核销售额在美国报章所作的报章公布全文。
- 由于本公司于二零零五年一月三十一日在美国作出报章公布（现转载如下），因此根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1) 条规定的披露责任而作出本公布。

以下为本公司于二零零五年一月三十一日就截至二零零四年十二月三十一日止三个月的未经审核业绩在美国报章所作的报章公布全文。

所有货币数字均以美元列账，除非特别指明。

报告内的财务报表数额按美国公认会计原则厘定。

### 概要

- 销售额增至 291,800,000 元，较二零零四年第三季 274,900,000 元上升 6.2%。
- 较 2004 年第三季晶圆付运增加 15.2% 至 303,796 片 8 吋等值晶圆。
- 每月产能增加至 120,417 件 8 吋等值晶圆。
- 中芯与台积电有关法律诉讼案件达成和解。

中国上海—二零零五年一月三十一日—国际主要半导体承包制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（「中芯」或「本公司」）于今日公布截至二零零四年十二月三十一日止三个月销售额由上一季度的 274,900,000 元增加 6.2% 至 291,800,000 元。

“我们很高兴地报告2004年第四季收入继续成长，”中芯国际总裁兼总执行长张汝京先生说。“在2004年第四季，我们新增19家客户，其中12家是中国的非厂房半导体公司。在全球半导体工业有所疲软的情况下，大中国地区却持续表现出强劲的增长，其收入超过总收入的10%，表明中国半导体的国内需求仍然在成长。老客户和新增客户的订单对我们95%的产能利用率做出了贡献。随着我们制程技术的继续扩展，我们预期在2005年上半年开始90纳米技术的试产。从商业运作和技术角度，2004年对中芯国际来说是意义非凡的一年，我们将在扎实的营运基础上不断致力于推进未来计划的基础工作。2005年我们将会继续扩展我们的12吋晶圆厂，并且预期会持续创造收入。”

“我们很高兴地宣布本公司与台积电对有关侵犯专利与不当使用商业机密之法律诉讼，达成协议。”中芯国际总裁兼总执行长张汝京先生说。“中芯国际与台积电达成协议。中芯国际，2005年1月30日于上海，发布以下声明：台积电与中芯国际，今天宣布两家公司，对有关侵犯专利与不当使用商业机密之法律诉讼，达成协议：根据本协议，中芯国际在未来6年内将支付总数1亿7千5百万美金之权利金给台积电。（前5年每年3千万美金，第6年支付2千5百万美金。）台积电有条件性的撤回所有以下台积电与中芯国际之间的法律诉讼案件，包括在美国联邦法院的，加州州立法院的，美国国际贸易委员会的，以及在台湾地区法院的所有诉讼案件。此协议中，双方的专利授权期限至2010年12月。台积电并不授予中芯国际使用商业机密的权利，但台积电同意对以往所提及的不当使用商业机密之案件不再控诉。如果中芯国际毁约的话，专利权的使用和这个协议将终止并且原案可能再度被提出，而且可加速权利金的给付。”

“我们很高兴这些诉讼案件得以顺利的达成和解，我们也相信这个和解有益于我们公司的股东们。”中芯国际执行长张汝京博士表示，“作为一个年轻而正在成长的公司，我们将继续与更多的国际公司合作，我们也要集中力量来加强我们对客户的服务。”

根据美国会计准则和相关适用的会计规则，本公司正在进行分析该事件对2004年第四季度和截止2004年12月31日的年度财务报表的影响。因而，本公司现在不能提供除了本业绩公布之外的有关2004年第四季度的经营结果或是有关2005年第一季度的指引。本公司预计将在六周内提供相关信息。

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：二零零五年一月三十一日

时间：上海时间下午八时正

拨号及登入密码：美国 1-617-847-8709（密码：SMIC）或香港852-3002-1672（密码：SMIC）。

二零零四年第四季业绩公布网上直播可于 [www.smics.com](http://www.smics.com) 网站「投资者关系」一栏收听。中芯网站在网上广播后为十二个月提供网上广播录音版本连同本新闻发布的软拷贝。

## 有关中芯

中芯（纽约交易所：SMI；香港联交所：0981.HK）是全球首屈一指的半导体承包制造厂之一。作为一家半导体承包制造厂，中芯提供以 0.35 微米至 0.13 微米技术制造的集成电路。中芯成立于二零零零年四月，是一家开曼群岛公司，于中国上海张江高科技园区营运三间 8 吋晶圆代工厂，以及于天津营运一间 8 吋晶圆代工厂。此外，中芯最近在中国北京的新 12 吋晶圆装配厂房开始试产。为向客户提供高品质的服务，中芯国际还营运在美国、欧洲、日本的客户服务和市场销售办公室。中芯国际努力达到甚至超越各项国际标准并已获得 ISO9001, ISO/TS16949, OHSAS18001, TL9000 和 ISO14001 国际认证。其它资料详情，请浏览 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

## 安全港声明

（根据 1995 私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据1995私人有价证券诉讼改革法案所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用「相信」、「预期」、「计划」、「估计」、「预计」、「预测」及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，为并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知风险、不确定性，以及其它可能导致中芯实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，包括（但不限于）中芯与台积电有关法律诉讼案件达成和解对 2004 年第四季度和截止 2004 年 12 月 31 日的年度财务报表(以后四至六周内将公布)的影响，与半导体行业周期及市场状况有关的风险、激烈竞争、中芯客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯量产新产品的能力、半导体承包制造服务供求情况、市场产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造生产量供给及最终市场的金融局势是否稳定。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（「证交会」）的文件资料，包括其于二零零四年三月十一日以 F-1 表格（经修订）形式呈交予证交会的登记声明，特别是「风险因素」及

「有关财务状况及经营业绩的管理层讨论及分析」两个部份、其于二零零四年三月八日以A-1表格形式呈交予香港联合交易所（「香港联交所」）的登记声明以及中芯可能不时向证交会及香港联交所呈交的该等其它文件，包括 6-K 表格。其它未知或不可逆料的因素亦可能会对中芯日后的业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于上述风险、不确定性、假设及因素，本新闻发布中提及的前瞻性事件可能不会发生。务请阁下注意，切勿过份依赖此等前瞻性陈述，此等陈述仅就本新闻发布中所载述日期（或如无有关日期，则本新闻发布日期）的情况而表述。

除法律有所规定以外，中芯概不就因新资料、未来事件或其它原因引起的任何情况承担任何责任，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

投资者联络资料：

**Jimmy Lai**

投资者关系部负责人

电话：86-21-5080-2000，内线 16088

传真：86-21-5080-3070

**Calvin Lau**

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16693

传真：86-21-5080-3070

**Evonne Hwang**

投资者关系部

电话：86-21-5080-2000，内线 16275

传真：86-21-5080-3070

概要:

以千美元为单位 (营运数据除外)

|                     | <u>二零零四年</u><br><u>第四季度</u> | <u>二零零四年</u><br><u>第三季度</u> | <u>季度比较</u> | <u>二零零三年</u><br><u>第四季度</u> | <u>年度比较</u> |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 销售                  | 291,842                     | 274,897                     | 6.2%        | 145,047                     | 101.2%      |
| 付运晶圆 (千片 8 吋等值) (1) | 303,796                     | 263,808                     | 15.2%       | 153,125                     | 98.4%       |
| 综合平均售价              | \$917                       | \$991                       | -7.5%       | \$910                       | 0.8%        |
| 逻辑平均售价(2)           | \$1,020                     | \$1,091                     | -6.5%       | 967                         | 5.5%        |
| 产能使用率               | 95%                         | 99%                         |             | 97%                         |             |

附注:

(1) 包括铜接连线

(2) 不包括铜接连线

- 销售额增至 291,800,000 元, 较二零零四年第三季的 274,900,000 元录得季度升幅 6.2%, 并较二零零三年第四季的 145,000,000 元录得年度升幅 101.2%。导致此等上升的主要因素如下:
  - 二零零四年第四季末产能增加至 120,417 片 8 吋晶圆;
  - 晶圆付运增至 303,796 片, 较二零零四年第三季的 263,808 片录得季度升幅 15.2%;

## 1. 收入分析

| 销售分析         |                            |                            |                            |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 以应用分类        | <u>二零零四年</u><br><u>第四季</u> | <u>二零零四年</u><br><u>第三季</u> | <u>二零零四年</u><br><u>第二季</u> | <u>二零零三年</u><br><u>第一季</u> | <u>二零零三年</u><br><u>第四季</u> |
| 计算机          | 26.8%                      | 20.5%                      | 22.5%                      | 25.1%                      | 26.7%                      |
| 通讯           | 58.1%                      | 57.2%                      | 54.3%                      | 56.0%                      | 55.8%                      |
| 消费           | 10.2%                      | 17.1%                      | 17.1%                      | 12.7%                      | 13.5%                      |
| 其它           | 4.9%                       | 5.2%                       | 6.1%                       | 6.2%                       | 4.0%                       |
| 以装置分类        | <u>二零零四年</u><br><u>第四季</u> | <u>二零零四年</u><br><u>第三季</u> | <u>二零零四年</u><br><u>第二季</u> | <u>二零零三年</u><br><u>第一季</u> | <u>二零零三年</u><br><u>第四季</u> |
| 逻辑 (仅包括铜接连线) | 75.1%                      | 77.6%                      | 73.5%                      | 72.4%                      | 71.6%                      |
| DRAM (1)     | 20.4%                      | 17.5%                      | 20.8%                      | 21.6%                      | 24.5%                      |
| 其它 (光罩制造及探测) | 4.5%                       | 4.9%                       | 5.7%                       | 6.0%                       | 3.9%                       |

|                          | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零三年</u> | <u>二零零三年</u> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 以客户类别分类                  | <u>第四季</u>   | <u>第三季</u>   | <u>第二季</u>   | <u>第一季</u>   | <u>第四季</u>   |
| 非厂房半导体公司                 | 50.2%        | 35.3%        | 36.1%        | 36.6%        | 30.8%        |
| 集成装置制造商                  | 47.5%        | 56.3%        | 54.8%        | 54.0%        | 62.7%        |
| 系统公司及其它                  | 2.3%         | 8.4%         | 9.1%         | 9.4%         | 6.5%         |
|                          | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零三年</u> | <u>二零零三年</u> |
| 以地区分类                    | <u>第四季</u>   | <u>第三季</u>   | <u>第二季</u>   | <u>第一季</u>   | <u>第四季</u>   |
| 北美洲                      | 34.9%        | 41.8%        | 44.0%        | 41.4%        | 36.2%        |
| 亚太区（不包括日本）               | 43.5%        | 31.5%        | 26.5%        | 27.2%        | 28.6%        |
| 日本                       | 8.8%         | 15.6%        | 16.2%        | 16.3%        | 15.5%        |
| 欧洲                       | 12.8%        | 11.1%        | 13.3%        | 15.1%        | 19.7%        |
| <b>晶圆收入分析</b>            |              |              |              |              |              |
| 以技术分类<br>(仅包括逻辑、记忆及铜连接件) | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零三年</u> | <u>二零零三年</u> |
|                          | <u>第四季</u>   | <u>第三季</u>   | <u>第二季</u>   | <u>第一季</u>   | <u>第四季</u>   |
| 0.13 微米                  | 13.8%        | 11.9%        | 9.9%         | 10.1%        | 10.4%        |
| 0.15 微米                  | 14.9%        | 13.2%        | 13.3%        | 15.7%        | 17.5%        |
| 0.18 微米                  | 33.6%        | 46.2%        | 48.6%        | 44.4%        | 34.7%        |
| 0.25 微米                  | 6.0%         | 6.4%         | 8.3%         | 8.3%         | 10.6%        |
| 0.35 微米                  | 31.7%        | 22.3%        | 19.9%        | 21.5%        | 26.8%        |
|                          | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零三年</u> | <u>二零零三年</u> |
| 以逻辑分类(2)                 | <u>第四季</u>   | <u>第三季</u>   | <u>第二季</u>   | <u>第一季</u>   | <u>第四季</u>   |
| 0.13 微米                  | 2.4%         | 1.8%         | 0.9%         | 0.0%         | 0.0%         |
| 0.15 微米                  | 5.3%         | 4.6%         | 3.9%         | 4.4%         | 1.9%         |
| 0.18 微米                  | 38.2%        | 56.2%        | 63.0%        | 58.5%        | 52.9%        |
| 0.25 微米                  | 7.8%         | 6.1%         | 3.1%         | 5.0%         | 3.4%         |
| 0.35 微米                  | 46.3%        | 31.3%        | 29.1%        | 32.1%        | 41.8%        |

附注：

- (1) 先前所用的是“记忆体”一词，但是所有历史报告在这个类别中都仅仅包括 DRAM 装置。
- (2) 不包括 0.13 微米铜接连件

- 相较二零零四年第三季而言，二零零四年第四季电脑类别的销售额较其它应用技术增长更快。

- 二零零四年第四季逻辑晶圆(包括铜接连件) 的销售百分比下降至占销售额的 75.1%，二零零四年第三季则为 77.6%。
- 非厂房半导体公司占二零零四年第四季销售额 50.2%，二零零四年第三季则为 35.3%。
- 二零零四年第三季源自亚太客户（不包括日本）的销售百分比上升至 43.5%，二零零四年第三季度则为 31.5%，上升主要原因是由于大中华地区占了二零零四年第四季销售总额的 13.4%，二零零四年第三季为 6.6%。
- 二零零四年第四季 0.18 微米及以下技术的销售百分比占销售额下降至 62.3%，二零零四年第三季度为 71.3%。

产能:

| <u>厂 / (晶圆尺寸)</u> | <u>二零零四年第四季</u> | <u>二零零四年第三季</u> |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 一厂 (8 吋)          | 45,536          | 38,820          |
| 二厂 (8 吋)          | 35,870          | 34,824          |
| 四厂 (12 吋)         | 7,027           | 0               |
| 七厂 (8 吋)          | 14,182          | 10,322          |
| 每月晶圆装配总产能         | 102,615         | 83,966          |
| 铜接连件:             |                 |                 |
| 三厂 (8 吋)          | 17,802          | 15,077          |
| 每月铜接连件总产能         | 17,802          | 15,077          |

附注:

(1) 期终每月晶圆计，8 吋等值晶圆。

\* 截至二零零四年第四季度终结时，每月产能增加至 120,417 件晶圆。

付运及使用率：

| <u>8 吋晶圆</u>       | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零四年</u> | <u>二零零三年</u> | <u>二零零三年</u> |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | <u>第四季</u>   | <u>第三季</u>   | <u>第二季</u>   | <u>第一季</u>   | <u>第四季</u>   |
| 付运晶圆（包括铜接连件）       | 303,796      | 263,808      | 201,534      | 174,325      | 153,125      |
| 使用率 <sup>(1)</sup> | 95%          | 99%          | 99%          | 99%          | 97%          |

附注：

(1) 使用率按输出晶圆总额除以估计产能计算

- 二零零四年第四季晶圆付运量为 303,796 件 8 吋晶圆，分别较二零零四年第三季的 263,808 片及二零零三年第四季度的 153,125 片上升 15.2% 及 98.4%。
- 使用率下降至 95%。

综合平均售价趋势

逻辑平均售价趋势 (不包括 0.13 微米铜接连件)

二零零四年第四季综合平均售价分别由二零零四年第三季的 991 元下降至 917 元，主要原因在于本公司转而生产更多成熟的逻辑晶圆以及 DRAM 的定价压力。

二零零四年第三季逻辑平均售价（不包括 0.13 微米铜接连件）分别由二零零四年第三季的 1,091 元下降至 1,020 元。主要原因在于本公司转而生产更多成熟的逻辑晶圆。

## 2. 二零零五年第一季展望及指引

- 晶圆付运预期下降 6%。
- 使用率预计下降约至 85%。
- 综合 ASP 预计与上季相比下降 12%。



### **3. 近期公布**

- 中芯与台积电有关法律诉讼案件达成和解。(二零零五年一月三十一日)
- 中芯国际更新二零零四年第四季度指引。(二零零四年十二月二十二日)
- 上海方泰与中芯国际签订战略合作协议。(二零零四年十二月九日)
- 芯原为凯明 3G TD-SCDMA 芯片提供后端设计服务，使用中芯国际0.18 微米工艺制程一次流片成功。(二零零四年十二月八日)

上述公布详情请参阅中芯网站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

于本公布刊发日期，本公司董事分别有董事会主席及执行董事张汝京、非执行董事蔡来兴、姚方（蔡来兴的替任董事）、独立非执行董事徐大麟、周延鹏、川西刚、麋河、陈立武及王阳元。

承董事会命

中芯国际集成电路制造有限公司

主席

张汝京

香港，二零零五年一月三十一日

\* 仅供识别